

東京エレクトロン

2008年3月期 第3四半期 決算説明会

2008年2月5日

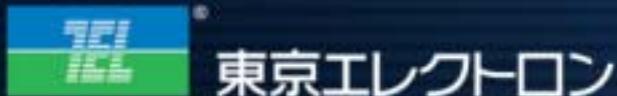
資料取扱い上の注意

将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体／FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は円単位で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2008年3月期 第3四半期 決算概要

経理部 部長 佐伯 幸雄

2008年2月5日

2008年3月期 第3四半期決算(連結)

第3四半期業績

(単位:億円)

	2007年3月期		2008年3月期			
	3Q	1Q-3Q計	3Q	対前年増減	1Q-3Q計	対前年増減
売上高	2,100	6,006	1,998	-4.9%	6,762	12.6%
SPE	1,588	4,427	1,607	1.2%	5,399	22.0%
FPD	260	785	100	-61.4%	536	-31.7%
EC/CN	249	785	289	15.9%	822	4.8%
その他	2	8	0	-71.2%	3	-60.8%
売上総利益	739 (35.2%)	1,933 (32.2%)	724 (36.2%)	-2.1%	2,377 (35.2%)	23.0%
販管費	310	921	339	28億円	1,042	120億円
営業利益	429 (20.4%)	1,011 (16.8%)	384 (19.3%)	-44億円	1,335 (19.7%)	323億円
経常利益	421	1,003	397	-23億円	1,355	352億円
税前利益	421	1,006	400	-21億円	1,382	376億円
当期純利益	269	642	256	-13億円	880	238億円
研究開発費	133	404	159	25億円	478	73億円
設備投資額	93	189	41	-51億円	169	-20億円
減価償却実施額	48	136	55	7億円	153	17億円

SPE: 半導体製造装置, FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク

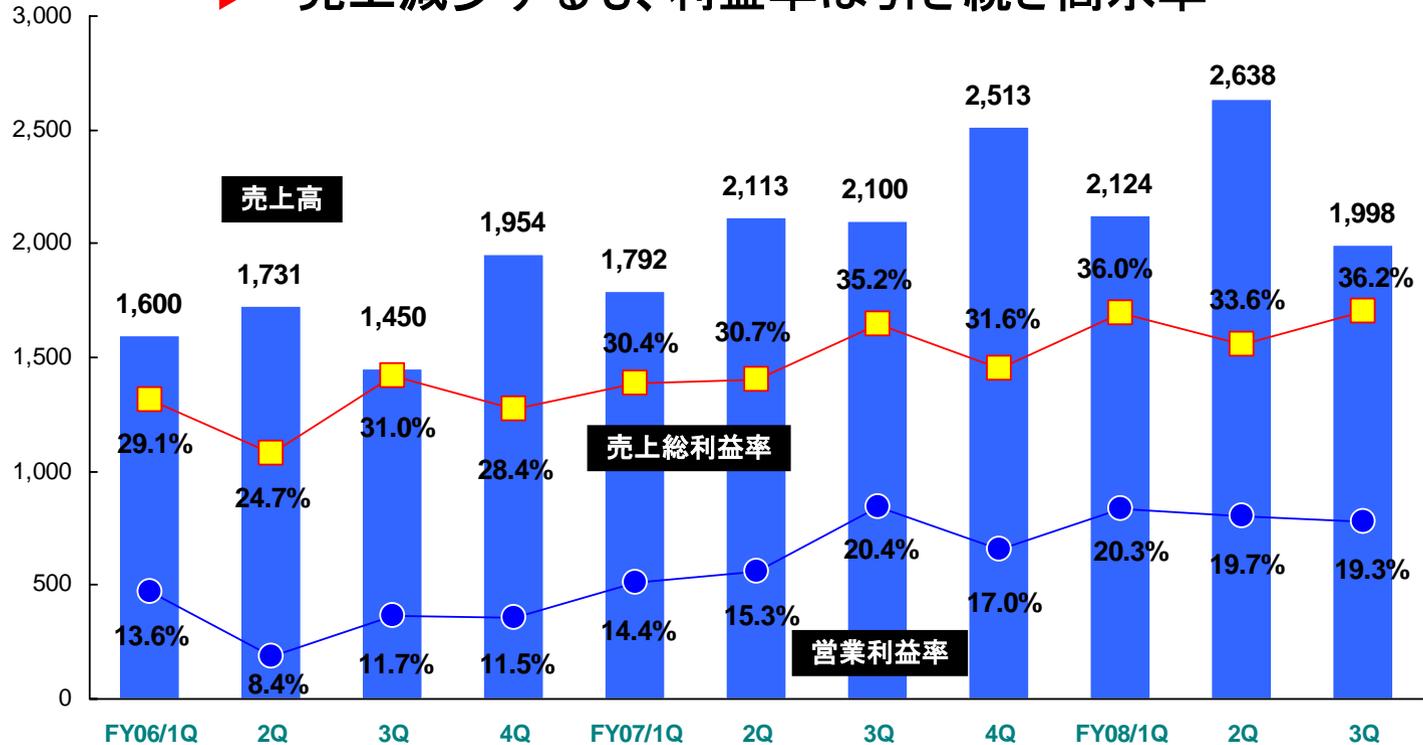


2008年3月期 第3四半期決算(連結)

売上・利益率推移

(単位:億円)

▶▶ 売上減少するも、利益率は引き続き高水準

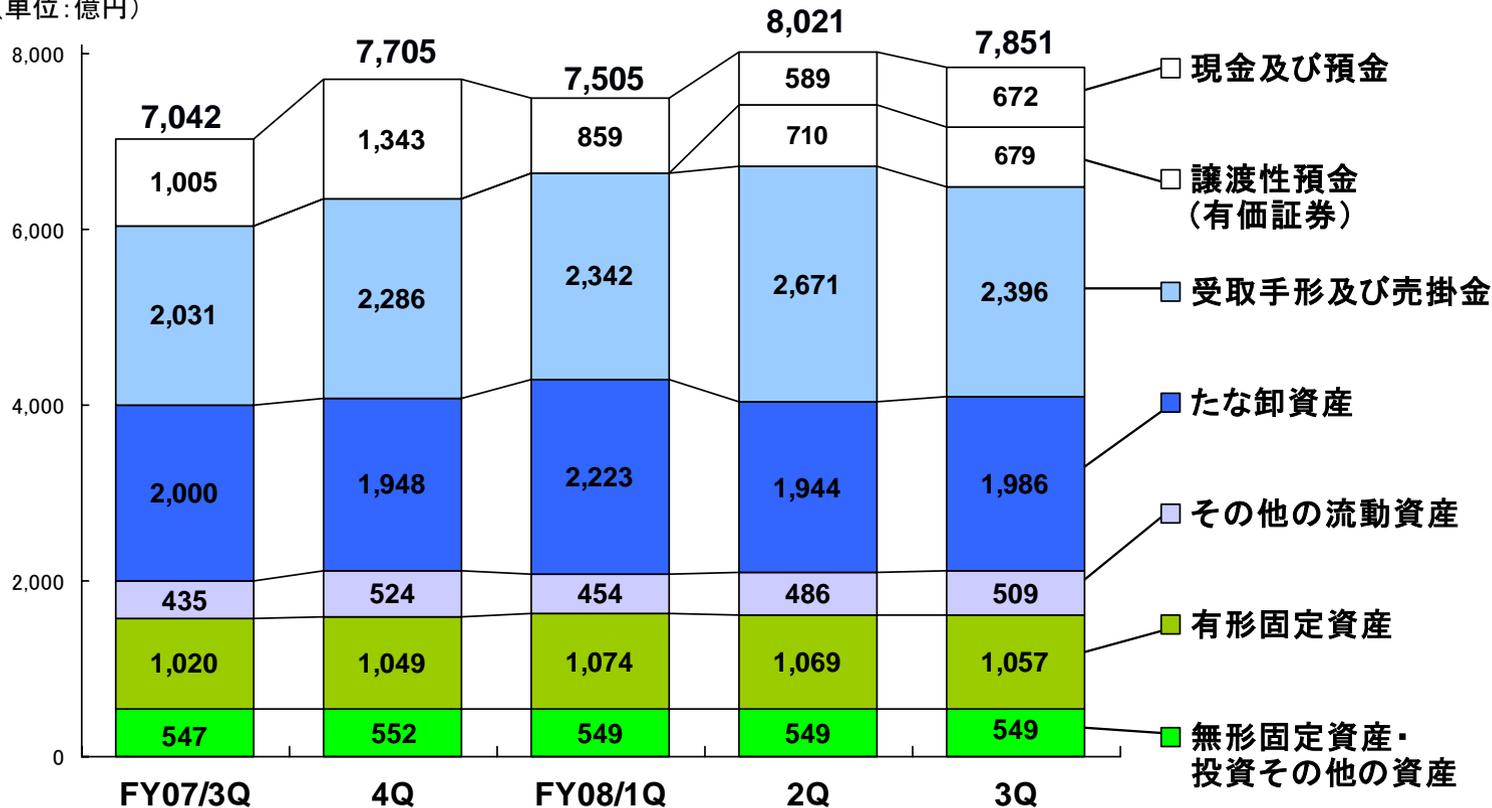


2008年3月期 第3四半期決算(連結)

資産

▶▶ 総資産は、前期末比146億円の増加

(単位:億円)



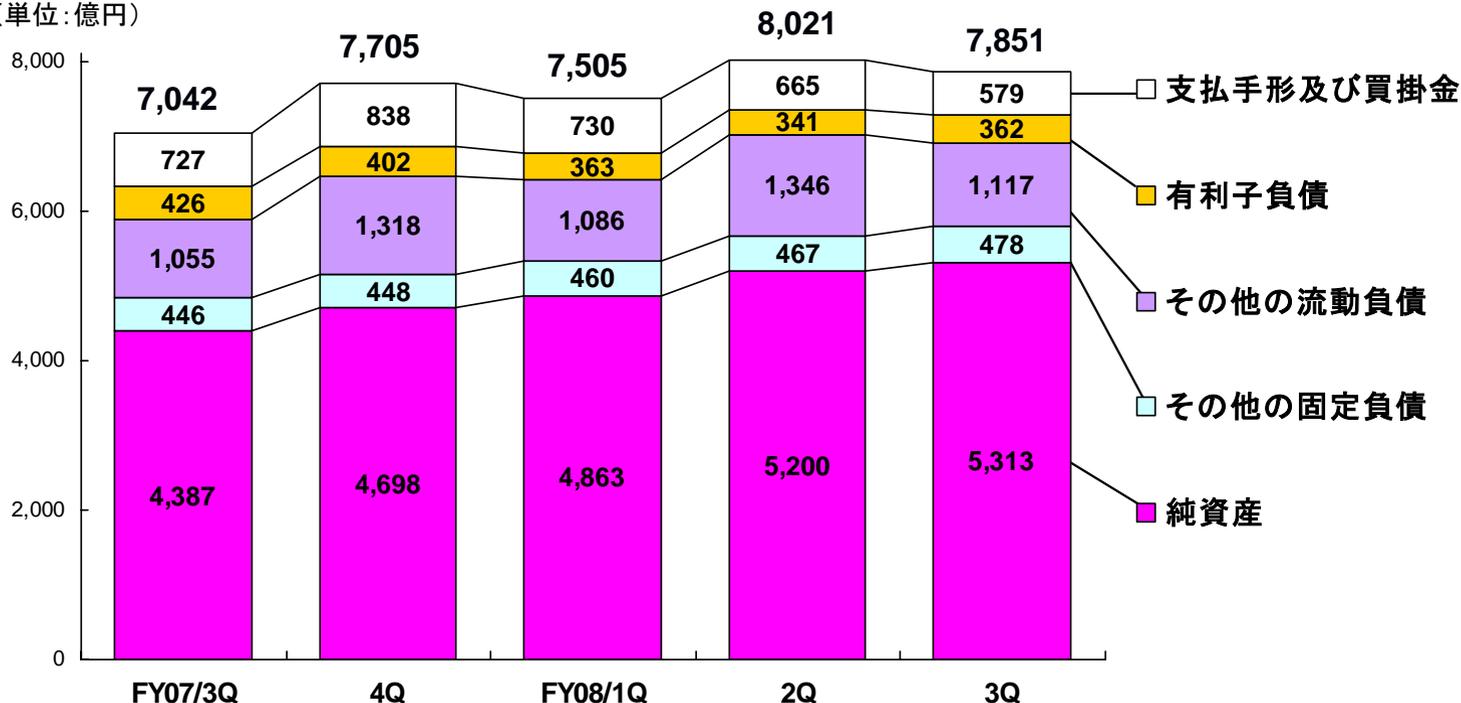
*従来、「現金及び預金」に含まれていた「譲渡性預金」は、FY08/2Qより区別して表示しております。



負債・純資産

▶▶ 利益剰余金の増加で、純資産は前期末比615億円の増加

(単位:億円)



有利子負債/自己資本

9.9%

8.7%

7.6%

6.7%

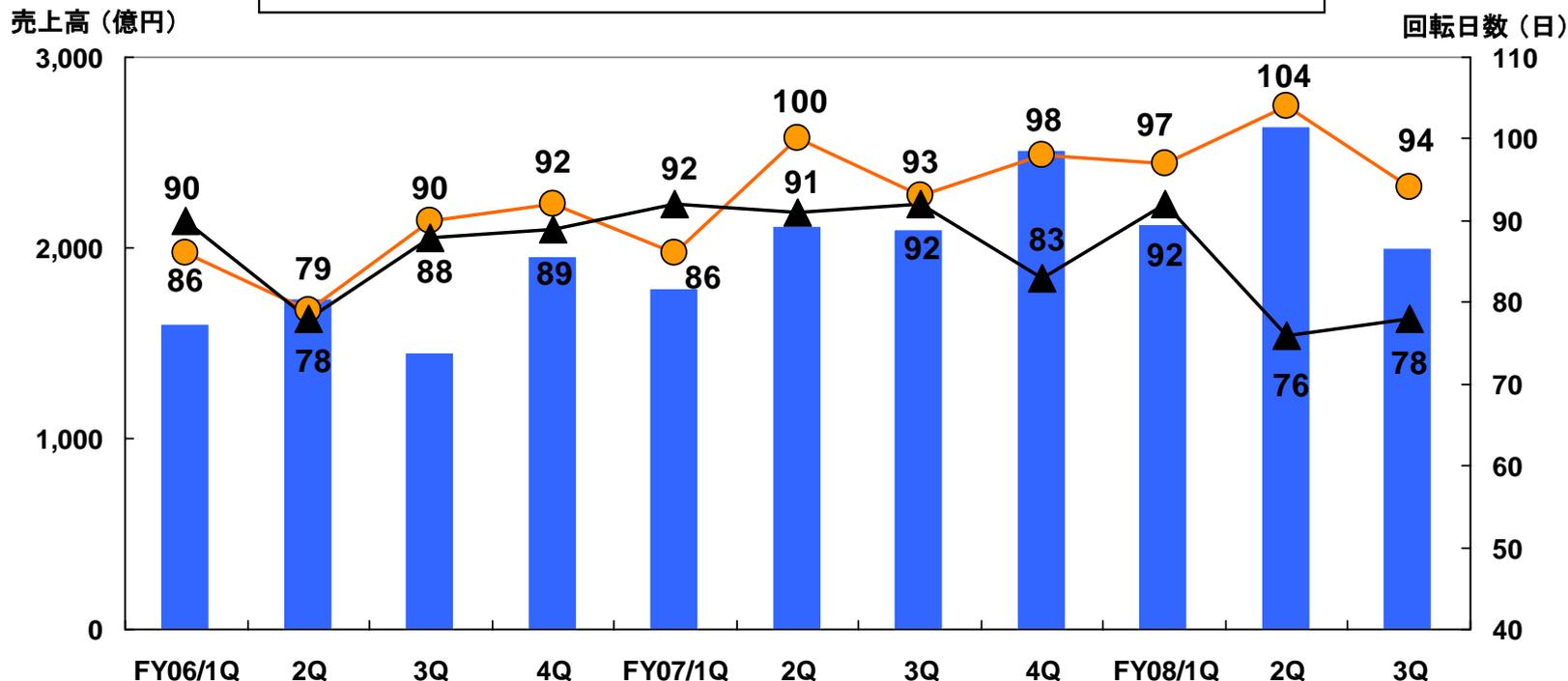
7.0%

* 自己資本＝純資産-(新株予約権+少数株主持分)



2008年3月期 第3四半期決算(連結)

たな卸資産・売上債権の回転日数



*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

* FY2006/1Qの回転日数算出に使用したFY2005/2Q売上高 = 新会計方針によるFY2005/1Hの売上高 ÷ 2



2008年3月期 第3四半期決算(連結)

キャッシュ・フロー

▶▶ 1Q-3Q 9ヶ月: 前年同期比で営業キャッシュフローが234億円増加

(単位: 億円)

	2007年3月期	2008年3月期	
	1Q-3Q (9ヶ月)	3Q (3ヶ月)	1Q-3Q (9ヶ月)
営業活動によるキャッシュ・フロー	178	206	412
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲247	▲389 *	▲474 *
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲327	▲104	▲268
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	▲0	▲1
現金及び現金同等物の増加額	▲394	▲287	▲332
現金及び現金同等物の期末残高	1,005	1,011	

* 3ヶ月超の預金への支出340億円を含む

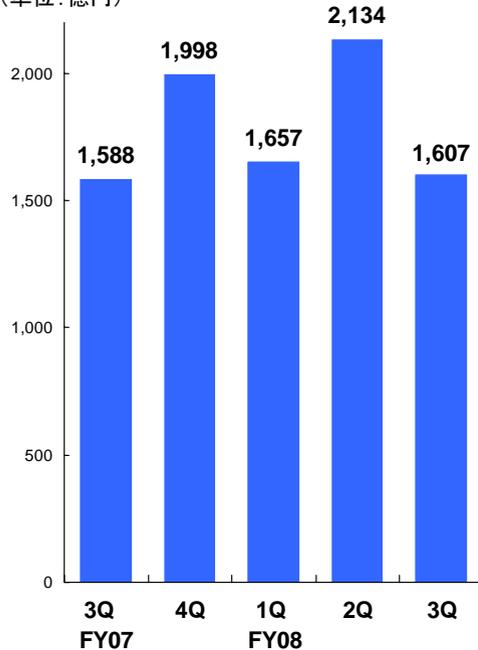


2008年3月期 第3四半期決算(連結)

部門別売上高

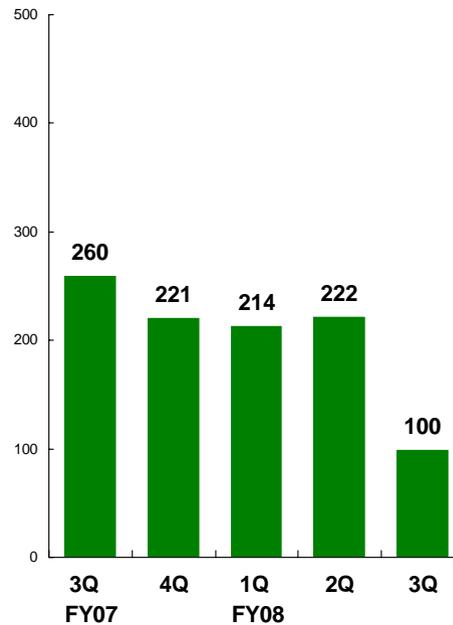
SPE部門 (半導体製造装置)

(単位: 億円)



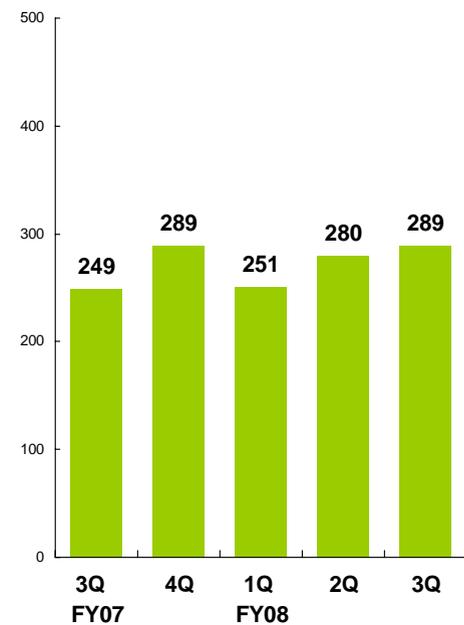
FPD部門 (フラットパネルディスプレイ製造装置)

(単位: 億円)



EC/CN部門 (電子部品/コンピュータ・ネットワーク)

(単位: 億円)



*上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります(当3Q売上高、1億円未満)。

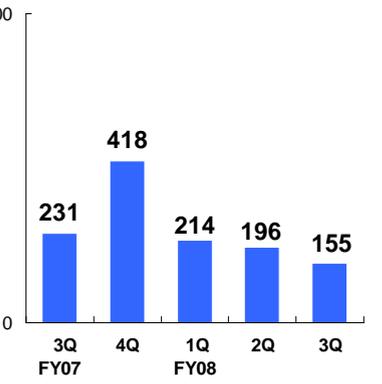
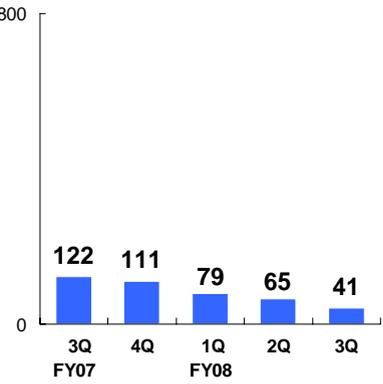
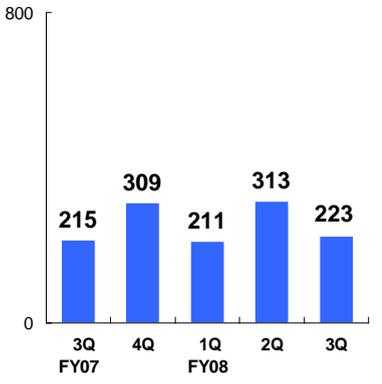
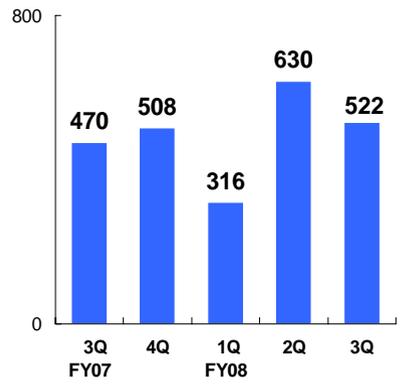


2008年3月期 第3四半期決算(連結)

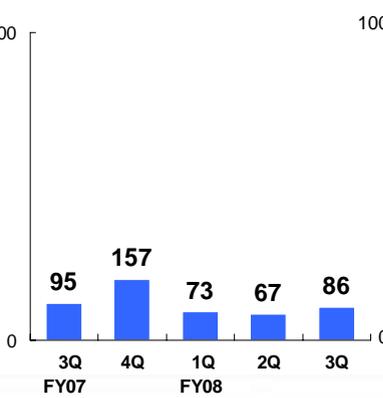
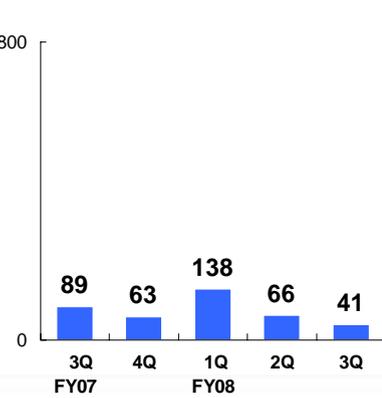
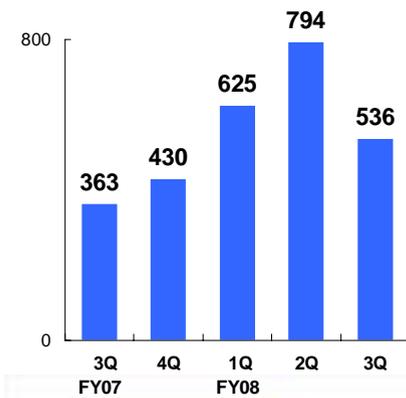
SPE部門地域別売上高

(単位:億円)

日本 米国 欧州 韓国



台湾 中国 東南アジア他 地域別構成比

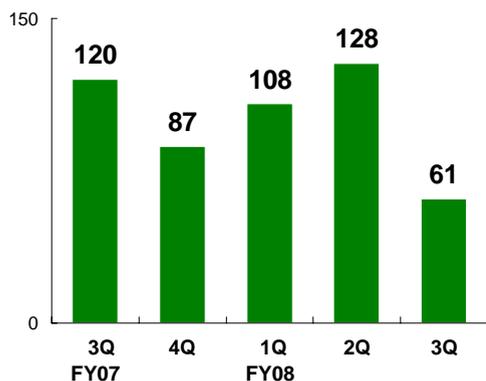


2008年3月期 第3四半期決算(連結)

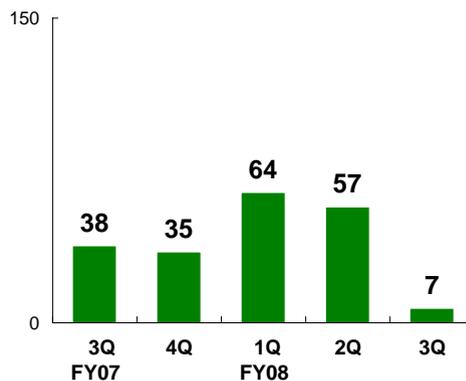
FPD部門地域別売上高

(単位:億円)

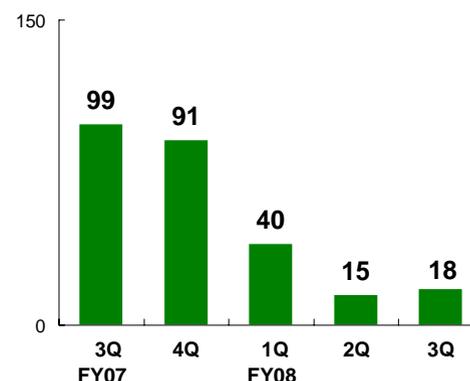
日本



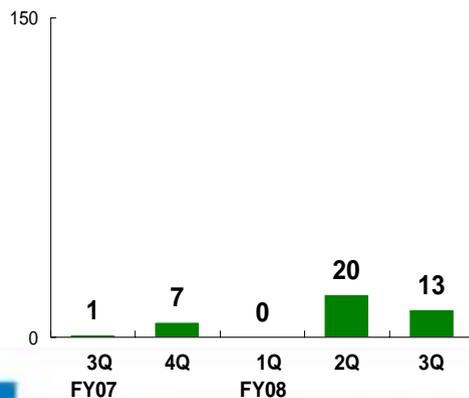
韓国



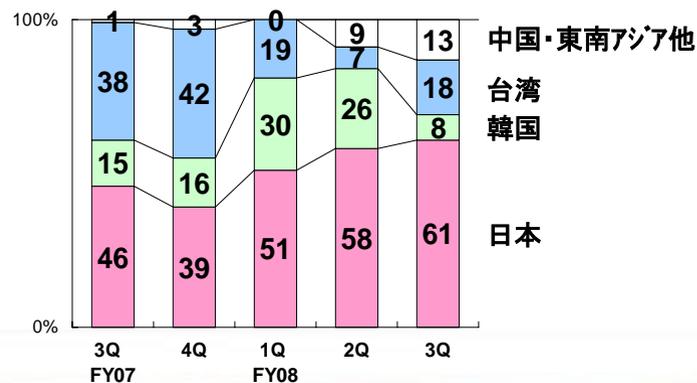
台湾



中国・東南アジア他



地域別構成比



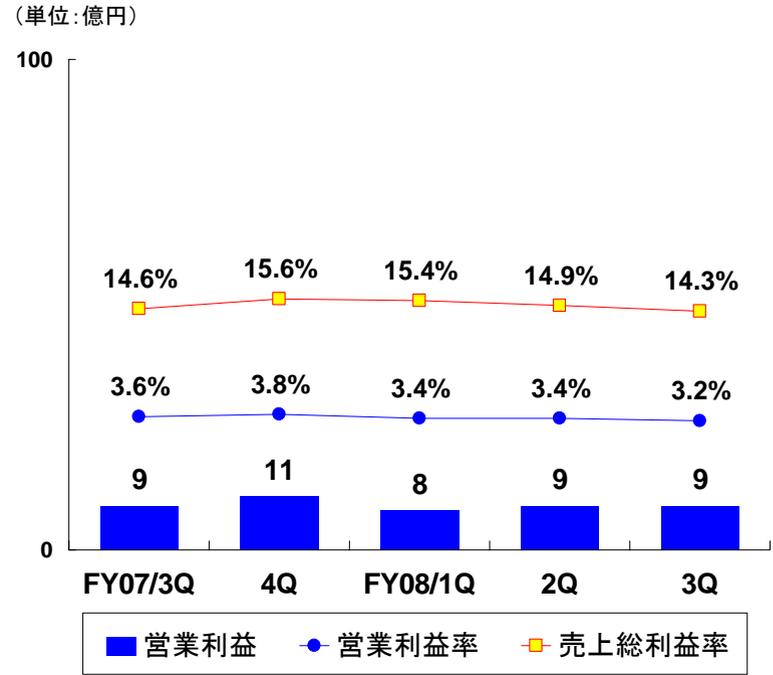
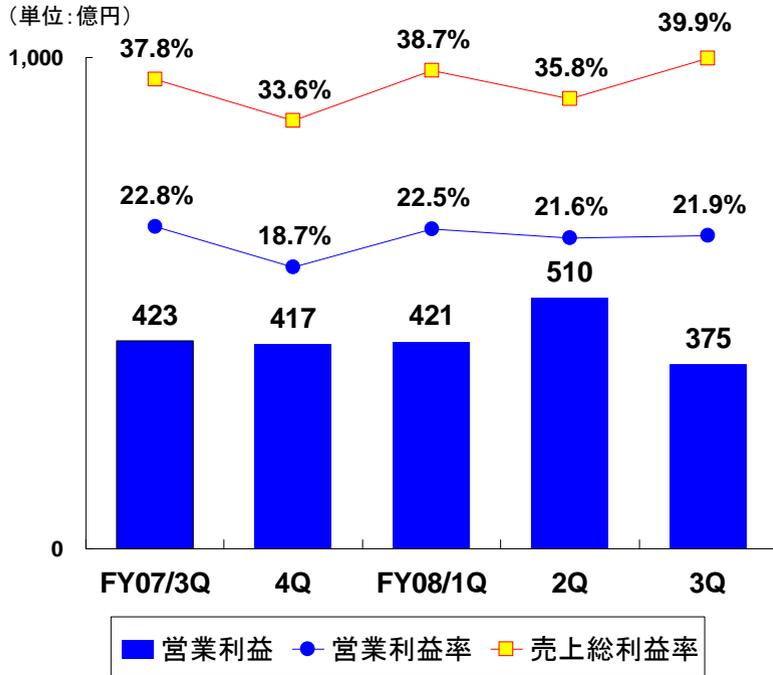
事業の種類別セグメント情報

産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、その他)

電子部品・情報通信機器

(電子部品、コンピュータ・ネットワーク)

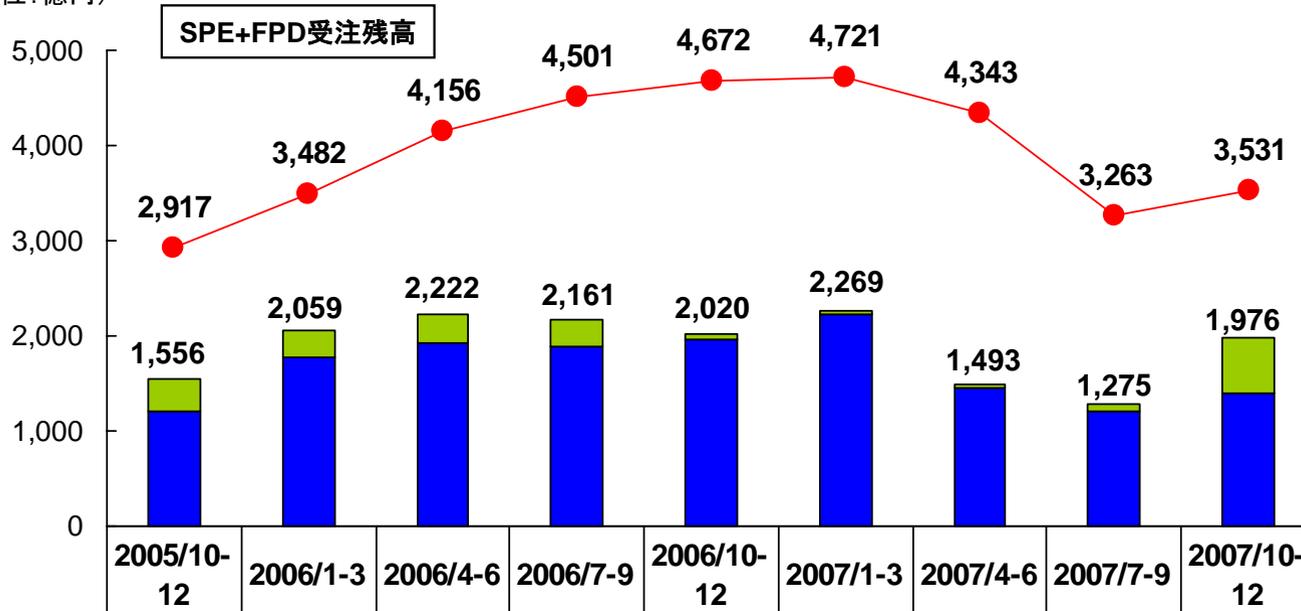


●セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。



SPE+FPD受注額, 受注残高

(単位: 億円)



FPD製造装置 受注額	344	277	296	275	55	42	41	73	573	
半導体製造装置 受注額	1,211	1,782	1,926	1,886	1,964	2,227	1,452	1,202	1,403	
受注残高	2,917	3,482	4,156	4,501	4,672	4,721	4,343	3,263	3,531	
受注残高内訳	FPD	927	990	997	1,036	831	652	479	331	803
	SPE	1,990	2,491	3,158	3,464	3,841	4,069	3,864	2,931	2,727

●2006年1-3月期より、受注額・受注残高ともに連結ベースに表示変更しています。



